

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2016-014

南通富士通微电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曲溯景昌	董事	工作原因	福井明人
八重樫郁雄	董事	工作原因	福井明人

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 748,177,011 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号		江苏省南通市崇川路 288 号
传真	0513-85058929	0513-85058929	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com	nfme_stock@fujitsu-nt.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为集成电路封装测试。报告期内，公司总体经营情况良好，客户、产品结构不断优化，新产品研发及市场开拓进入收获期。2015 年全年实现营业收入 23.22 亿元，同比增长 11.06%；归属于上市公司股东的净利润 1.47 亿元，同比增长 21.93%。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	2,321,903,112.69	2,090,685,769.17	11.06%	1,767,322,278.64
归属于上市公司股东的净利润	147,325,358.32	120,824,422.34	21.93%	60,660,291.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,601,509.15	47,290,142.96	-60.67%	26,543,501.43
经营活动产生的现金流量净额	231,402,755.80	415,074,338.01	-44.25%	309,429,452.35
基本每股收益（元/股）	0.210	0.190	10.53%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.210	0.190	10.53%	0.09
加权平均净资产收益率	4.50%	5.23%	-0.73%	2.72%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	6,511,942,944.85	3,955,052,997.76	64.65%	3,686,188,070.23
归属于上市公司股东的净资产	3,740,388,672.42	2,364,489,470.95	58.19%	2,256,122,777.31

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	512,517,118.49	597,637,985.74	585,433,800.31	626,314,208.15
归属于上市公司股东的净利润	34,668,122.76	49,457,098.44	37,669,221.74	25,530,915.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,027,760.37	20,462,767.02	-18,601,601.03	712,582.79
经营活动产生的现金流量净额	74,330,030.26	22,926,100.34	73,513,981.19	60,632,644.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,746	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	31.09%	232,634,400	0	质押	74,100,000	
富士通(中国)有限公司	境外法人	21.38%	159,993,600	0			
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.19%	16,359,447	16,359,447			
山西证券股份有限公司	国有法人	1.56%	11,692,473	9,892,473			
国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发 22 号资产管理计划	其他	1.37%	10,215,081	10,215,081			
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.31%	9,831,029	9,831,029			
国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发 23 号资产	其他	0.89%	6,682,000	6,682,000			

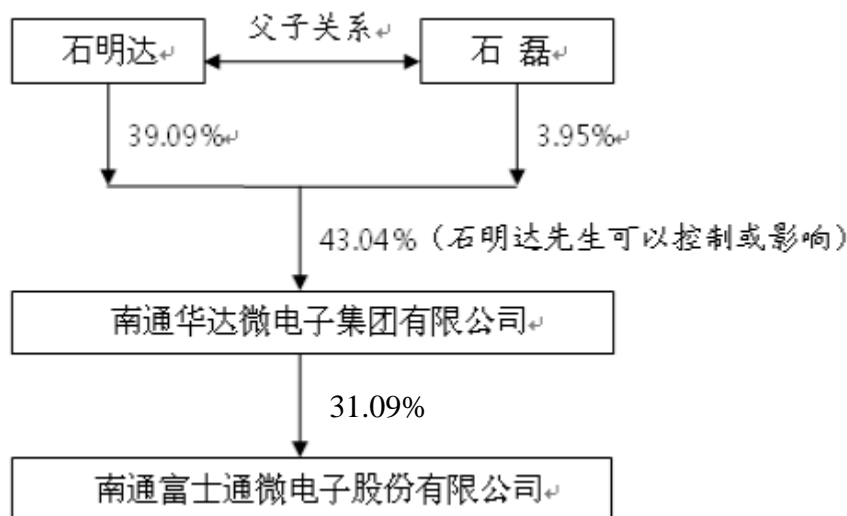
管理计划						
财通基金—平安银行—北京国际信托—北京信托 盈通宝 2 号集合资金信托计划第二期	其他	0.70%	5,238,095	5,238,095		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 168 号资产管理计划	其他	0.62%	4,623,657	4,623,657		
华安基金—兴业银行—常州投资集团有限公司	其他	0.62%	4,608,294	4,608,294		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中：第 1 和第 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	0					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）报告期经营情况概述

综观全球半导体产业的发展，2015年受到中国内地市场成长趋缓影响，以及计算机系统产业出现较大幅度衰退，智能型手机成长动能趋缓等因素，导致全球半导体产业与2014年相比较，2015年只微幅成长1.2%，约为3,399亿美元。

国际市场竞争加剧，国内政策、资金环境改善都将促使全球产业格局发生改变。2014年国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，并制定了集成电路产业三大发展目标，同时，国家集成电路产业投资基金项目启动，为本土集成电路产业发展解决资金问题。政策与资金的双向驱动下，为国内集成电路产业提供了良好的发展环境。同时，芯片国产化进程加快，也将成为产业另一个发展趋势，我国集成电路产业将迎来历史发展机遇。

2015年，是公司为抓住有利机遇实现大发展继续蓄力的一年，也是公司进一步明确发展思路、向集团化、国际化迈出重要一步的一年。报告期内，公司总体经营情况良好，保持了较好的发展势头，完成产量116亿块，同比增长15%；实现销售收入23亿元，同比增长11%；实现利润1.47亿元，同比增长21.39%。报告期内公司主要完成了以下几个方面工作：

(1) 市场拓展方面

产品结构：按照公司的产品策略，重点推进BGA，WLCSP，FC，QFN等系列的产品，BGA、QFN、FC等先进封装的比例由2014年的35%上升至40%左右；12英寸28纳米Bumping的技术突破后，在通讯领域的高端封装订单成长迅猛；PA、指纹识别、IPM模块、DTV等产品应用领域打开市场，为2016年增量打下基础。针对上述先进封装产品良好的发展趋势，公司适时加大了部分设备投入，预计这些设备将在后期发挥更大的作用。

客户结构：公司客户结构已基本形成了欧美、亚太、国内三分天下的局面；重点关注联发科、瑞昱、大中积体、华为（海思）、中兴通讯、展讯、联芯、锐迪科、国民技术、国科等国内外大的设计公司的业务发展，设计公司产品份额大幅提升，打破了多年来IDM公司包揽公司销售收入前三位的状况。

全力配合新工厂建设：2015年，公司产业基地布局工作紧锣密鼓向前推进，苏通工厂和合肥工厂一期工程相继封顶，进入内部安装阶段，预计2016年上半年投入使用，建成后将成为公司重要的封装产品产业化基地。目前，苏通工厂、合肥工厂已基本落实多家客户首批导入工作，并为后续导入打好基础。

(2) 技术创新方面

2015年，国内第一条12英寸28纳米先进封装测试全制程（Bumping+CP+FC+FT+SLT）生产线在公司成功量产，一流技术水平，使得我们国家的先进封装技术和世界先进水平的差距从5年缩短到3年，对国内集成电路产业链发展有着重要的里程碑意义。

LGA43指纹识别、BGA961产品（1214根线）及多排LQFP框架、IPM200W新品开发，miniDFN开发、QFN产品裸Cu线开发等新产品、新工艺应用已经或正在通过客户考核中。

(3) 跨境并购

2015年10月，公司发布公告，宣布收购AMD苏州和AMD槟城两家封测工厂各85%的股份。本次并购是公司实施兼并重组外延式发展战略的重要举措，对于提升公司综合实力具有深远意义。

AMD拥有世界先进的倒装芯片封测技术，主要产品应用于电脑、服务器、高端游戏主机、云计算中心等高端领域，与通富微电自主研发的适用于通信及消费市场的倒装芯片封测技术形成互补，将显著提升公司倒装芯片封测技术，使公司在倒装芯片封测领域的技术达到世界一流水平，提供封装品种最为完整的倒装芯片封测服务。这些技术与公司已经在规模量产的Bumping（凸点制造）技术相配合，将显著提升公司在高端封测领域的服务能力和竞争力，也使公司能够更好地支持国产CPU、GPU、网关服务器、基站处理器、FPGA（现场可编程门阵列）等产品的研发和量产。

本次交易完成后，两家标的公司将作为AMD主要的封测供应商，继续为AMD提供高质量的先进封测服务，同时，将充分利用AMD先进的技术、稳定的品质、成熟的团队，充分利用这个成熟的、大规模量产的平台，为国内外有高端封测需求的客户提供规模化、个性化的先进封测服务。公司预计，未来先进封装测试的收入将占到公司收入的70%以上，在全行业中处于领先地位。本次交易能够显著提升公司的封测技术水平，进一步扩大公司的生产规模，提高公司的盈利能力，使公司跻身世界一流封测企业的行列。

(4) 股票增发

2015年，公司完成了非公开发行股票工作，成功募集资金12.8亿元，为公司技术升级、扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。

(5) 团队建设

集成电路产业是全球竞争最充分、创新最无限产业，因此具有国际化视野、企业家式的高端人才、领军人才是企业能否实现跨越发展的关键。2015年，公司共引进总监级以上高级技术管理人才19名，他们都是行业内有着丰富技术和管理经验的翘楚；同时，引进招募大学毕业生350名。

(6) 架构调整

2015年，公司初步完成了集团化的组织架构调整，为2016年实现集团化运行管理奠定组织基础。

(7) 国家支持

以项目为载体，报告期内，公司“02”项目、科技项目、技改项目等获得各级政府的多项资金支持；苏通工厂已获得1.56亿国家专项建设基金支持，合肥工厂获得6.6亿国家专项建设基金支持；收购AMD苏州和AMD槟城两座封测工厂各85%的股份获得国家集成电路产业发展基金2.7亿多美金的支持。国家的支持极大增强公司实现跨越发展的信心和力量。

(二) 公司所处行业发展趋势

(1) 半导体行业成长与全球GDP成长密切相关。2016年全球宏观经济环境将充满挑战，半导体产业将面对全球宏观经济的一些逆风。中国作为世界第二大经济体，GDP成长预计将继续减速至6.5%左右。美国GDP增速可能较2015年略微上升，然而，为保持经济稳定，美国联邦储备局正考虑启动近十年的首次加息，这可能会影响其GDP成长；其他经济体的GDP成长可能同比相对较持平。整体来讲，预计全球GDP成长将经历连续第三年的低迷，仅略高于3%。全球宏观经济持续的低成长将导致半导体销售同比持平。

(2) 我们即将迈入“十三五”。政府“十三五”规划，体现出建设科技强国的决心，经济发展目标包括半导体等先进产业成为世界领先，拟用“互联网+”政策来振兴疲弱的经济成长，且相关研发经费将达GDP的2.5%。同时，按照《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的要求，2020年前我国集成电路产业的年均增长率要达到20%。公司作为国家重点集成电路企业和国家科技重大专项承担单位，将有望得到国家产业政策更多的扶持。

(3) 从经济与信息安全两方面出发，发展本土集成电路产业意义重大。据统计，芯片目前已经超越石油，成为大陆第一大进口商品，这为国家与电子信息产业发展都留下了极大的安全隐患。因此，国务院和江苏省相继出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》和《省政府关于加快全省集成电路产业发展的意见》，提出加快追赶和超越的步伐，努力实现“跨越式发展”。在国内集成电路产业良好的发展环境下，台湾芯片制造企业台积电拟出资30亿美元在南京建立独资芯片厂，据业界透露，台积电的建厂投资，将带动超过300亿美元的产业规模发展，芯片材料、芯片设计与芯片封装领域都将获得实质性的

需求提升。预计未来在继续利好的环境下，将有更多台湾半导体选择在国内建厂，将成为我国做大集成电路产业的催化剂。

(4) 从终端应用领域来看，传统消费电子产品和电脑终端市场已然成熟，且需求正逐渐减弱，但多个新的成长动力已在半导体行业出现，主要包括汽车电子和智能制造领域，将为集成电路企业提供更多市场空间。

汽车终端市场正加快其电气化、自动化和互联化进程，这主要由各国政府为提升燃油经济性和降低排放而制定日益严苛的法规所带动，而消费者也要求更高的安全性和更好的驾乘体验。这几大趋势正促进汽车应用半导体含量的持续成长。

智能制造是半导体行业的另一大趋势。未来5~10年，智能制造有望配置数以十亿计的智慧设备，应用到各行各业的智慧工厂，实现工业互联，构成高效互通、协同运转的制造系统。半导体可提供全面的产品阵容，用于智能制造方面的构建模组，具有安全可靠、可扩展的优势，加快智慧工厂的建设进程，快速配置相关生产及制造设备。

除以上的成长机会，电源方案供应商也将持续提供全面的高效电源和电池管理元件及模组产品阵容，以解决提升功率密度和效能不断成长的需求。这些产品用于各种不同应用，如不间断电源（UPS）、太阳能逆变器和个人电脑电源等。

公司在汽车电子产品及功率器件等产品方面具有多年大规模生产的经验积累。2015年，公司汽车电子产品需求较消费类、工业类产品需求旺盛，产品封装外形也从框架类向基板类转型，技术水平进一步提升。

物联网为代表的智能时代的到来，使得SiP成为趋势。半导体技术发展到今天，28nm的SOC产品是个节点，成本驱动的因素已经消失，而SiP可以弥补缺失的动力，对集成电路产业来讲是非常重要的时间窗口。公司发展的WLP、FC、BGA等先进封装工艺，将为全面量产SiP打下良好的基础。公司将密切关注终端应用市场发展情况，提供更符合市场需求的技术解决方案。

(5) 国外技术支持，助力集成电路技术更新换代。在国家对信息安全建设重视程度提高、扶持政策相继出台、移动互联网市场进一步发展的背景下，国外知名公司也纷纷向内地优秀企业抛出橄榄枝，愿意开展技术合作，这将为我国集成电路产业发展提供强力技术支撑。

在上述大背景下，公司正在开展收购AMD苏州和AMD槟城两座封测工厂各85%的股份。交割完成后，公司将承接AMD苏州和AMD槟城现有在集成电路封装测试领域的先进技术和相关业务，可对中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）以及加速处理器（APU）进行封装和测试，并将在包括APU、CPU、GPU、游戏主机处理器在内的芯片封装及测试技术，以及PGA封装技术、BGA-stiffener封装技术、BGA-coreless封装技术、LGA-coreless封装技术以及MCM技术等高端封装技术领域直接达到世界先进水平。

（三）公司面临的市场竞争格局

在市场竞争格局方面，目前国内集成电路封装测试企业已构成外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中，国际大型半导体企业纷纷在华建厂，无论在规模还是技术水平上占据着明显的优势。但同时，我国作为集成电路最大消费国，电子产品最大制造国。在政策鼓励下，我国集成电路公司海外并购趋势增强，这将是我国扩大产业规模并提高技术水平的一条捷径。

面对以上竞争格局，公司紧跟市场与客户需求，加快产品、工艺开发与创新：产品结构方面，成功开发出新款BGA产品、超薄QFN产品、eMMC产品，SiP、Bumping、WLCSP、FC等先进封装产品，国内第一条12英寸28纳米先进封装测试全制程（Bumping+CP+FC+FT+SLT）生产线在公司成功量产，BGA、QFN、FC等先进封装的比例大幅提升；客户结构方面，以市场为导向，及时做好区域客户结构调整优化工作，设计公司产品份额大幅提升。随着公司竞争能力的不断增强，公司开拓优质客户的能力不断提高，为公司收入的增长奠定了坚实的基础。

（四）公司发展战略及规划

（1）发展战略

为顺应当前良好的市场环境，公司内部推出三年翻一番的战略目标，并朝着该目标努力奋进。具体包括：公司坚持“服务与创新、进取与和谐”的经营理念，贯彻“顾客满意第一”的经营宗旨，为客户提供“一站式解决方案”；坚持发展主业的指导方针，提升主业盈利能力，采用自身内涵式发展和兼并重组外延式发展相结合的模式，促进公司产品结构调整和转型升级；坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业文化，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，努力使公司成为世界级的集成电路高端领域封装测试服务商，力争早日进入全球封测行业前十强，并努力使排名不断向前。

（2）公司2016年度经营目标

公司计划2016年实现营业收入29.08亿元，较2015年实绩增长25.24%。2016年，如超威半导体技术（中国）有限公司（“苏州目标公司”）及Advanced Micro Devices Export Sdn.Berhad（“槟城目标公司”）各85%的股权顺利交割，公司可将苏州目标公司及槟城目标公司纳入合并范围，2016年营业收入预计将达到51.52亿元，较2015年增长121.87%。该生产经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。

2016年，公司的优势很多，困难也不少，最主要的困难是经济大环境不好，经济下行压力大，市场竞争将更加激烈。围绕2016年的生产经营目标，我们将着重做好以下几方面的工作：

①开源——开拓市场、抢占市场，扩大销售，促进销售收入大提升

围绕公司产品策略要求，继续调整客户策略，以战略客户、重要客户、潜在客户为主，推进高端产品占比，通过提升客户服务水平，稳定并增加客户端市场份额；结合苏通工厂、合肥工厂的启动，积极推进老客户转产和新客户导入；针对风起云涌的集成电路购并浪潮，寻找机会，拓展新业务。

②节流——加大降本推进力度，提高产品竞争能力

围绕公司年度降本目标，做好技术优化方案，进一步提升设备利用率，点滴节约、减少浪费，全员、全过程、全方位的降本。

③注重协同效应，稳中求进、稳中求好

为适应国际化、集团化管理运行模式，理顺集团架构、明晰职权力关系；兼顾集团控制力与下属企业主观能动性；强化崇川总部的职能；确保苏通工厂、合肥工厂如期投产；确保苏州、槟城两座工厂顺利交割、平稳运行。

④围绕市场和现场，提升工艺工程创新、响应能力

更加重视传统产品，有计划的从技术降本、提高质量角度增强传统产品的竞争优势；加快新品研发考核速度和技术导入工作，着力提高工艺工程的保障能力；结合实施“02”专项，以市场为导向，加快先进封装技术的研发与应用，实现与国内主要设计公司封装需求的无缝对接；进一步做好知识产权工作。

⑤继续厉行精兵强政理念

加大人才的招聘力度，引进高端人才，重视本土人才的培养与使用，重视员工激励，完善绩效考核，保持一支优秀的不断壮大的员工队伍，为公司发展助力升级。

(3) 为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为保证公司当前业务所需，实现2016年度经营生产目标，完成在建投资项目，并为今后的发展做适当准备，公司及控股子公司南通通富、合肥通富计划2016年内在设施建设、生产设备、动力供应方面投资共计10.24亿元，主要用于BGA、QFN、WLCSP、SOT等产品扩产。2016年，如苏州目标公司及槟城目标公司各85%的股权顺利交割，苏州目标公司及槟城目标公司计划进行设备投资共计3.04亿元，主要用于FCBGA产品的填平补齐。

2015年，公司完成了非公开发行股票工作，成功募集资金12.8亿元；苏通工厂已获得1.56亿国家专项建设基金支持；合肥工厂获得6.6亿国家专项建设基金支持；收购AMD苏州和AMD槟城两座封测工厂各85%的股份获得国家集成电路产业发展基金2.7亿多美金的支持。此外，公司与合肥政府建立了合作关系，与银行保持长期密切合作，这些支持，为公司技术升级、扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。

(五) 公司的风险因素及应对措施

(1) 行业与市场波动的风险

全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，同时，如果产品市场竞争激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业波动给公司带来的经营风险。

(2) 新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

目前新兴产业、智能产业的发展对集成电路产品的要求也会越来越高。公司通过承担国家“02”专项，已经取得一定的科研成果。公司研发的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中，如出现一些波折或反复，将给公司生产经营造成一定影响。对此，公司通过引进高层次研发人才，主攻技术含量高、市场需求大的新产品，努力在技术研发层面上少走弯路；公司核心技术骨干和管理力量也将优先服务于新技术、新工艺、新产品，配合客户做好产品认证工作，提前预测产业化过程中有可能出现的问题，做好对策分析工作，缩短客户认证时间，确保新产品如期产业化。

(3) 原材料供应及价格变动风险

公司封装测试所需主要原材料为引线框架、键合丝和塑料料。公司主要原材料国内均有供应，公司有稳定的供应渠道。但公司外销业务比例较高，境外客户对封装的无铅化和产品质量要求较高，用于高端封装产品的主要原材料必须依赖进口。因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩产生一定影响。

(4) 外汇风险

2013年、2014年及2015年，公司出口销售收入占比分别为69.43%、73.07%、71.49%，外销收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路封装测试	2,310,124,127.83	1,815,579,342.08	21.41%	11.04%	7.37%	2.68%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度新纳入财务报表合并范围的子（孙）公司包括新设立的上海森凯、富润达、通润达、钜天投资以及非同一控制下企业合并取得的合肥通富。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

南通富士通微电子股份有限公司

董事长：石明达

2016 年 03 月 30 日